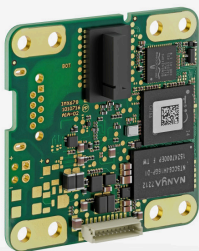
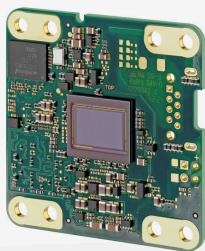


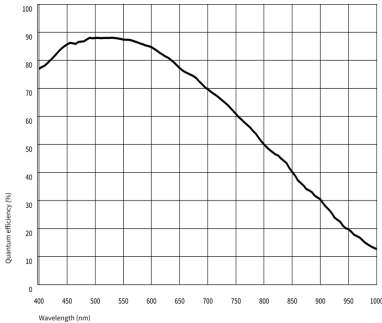
En serie
El modelo se está produciendo en serie y, por tanto, su disponibilidad a largo plazo está garantizada.



Especificación

Sensor

Tipo de sensor	CMOS Mono
Sistema de obturador	Global Shutter
Characteristic	Lineal
Clase de píxeles	3 MP
Resolución	3,20 Mpx
Resolución (h x v)	2064 x 1552 Pixel
Relación de aspecto	4:3
CAD	12 bit
Profundidad de color (caméra)	12 bit
Clase de sensor óptico	1/3,1"
Superficie optica	4,644 mm x 3,492 mm
Diagonal del sensor óptico	5,81 mm 1/3,1"
Tamaño de píxel	2,25 µm
CRA (Chief Ray Angle)	8 °
Fabricante	Sony
Denominación del sensor	IMX900-AMR-C
Ganancia (total/RGB)	16x/-
AOI horizontal	misma frecuencia de imagen
AOI vertical	mayor frecuencia de imagen
AOI ancho de imagen / ancho de paso	256 / 2
AOI alto de imagen / ancho de paso	1 / 1
AOI cuadrícula de posición (horizontal/vertical)	2 / 1
Binning horizontal	mayor frecuencia de imagen
Binning vertical	mayor frecuencia de imagen
Método binning	Horizontal: Promedio / Vertical: Promedio
Factor binning	2x2
Decimation (subsampling) horizontal	-
Decimation (subsampling) vertical	-
Método Decimation (subsampling)	M/C automático



Modelo

Frecuencia de imagen en modo libre	39 fps
Frecuencia de imágenes disparador (continúa)	39 fps
Frecuencia de imágenes disparador (máxima)	50 fps
Tiempo de exposición (mínimo - máximo)	0,023 ms - 2000 ms
Consumo de potencia	2 W - 3,4 W
Memoria gráfica	128 MB

HDR

Modo	QuadHDR
------	---------

Condiciones ambientales

Para versiones de placa tenga en cuenta las indicaciones específicas que figuran en la documentación pertinente.

Temperatura del aparato permitida durante el funcionamiento	0 °C - 80 °C / 32 °F - 176 °F
Temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento	0 °C - 25 °C / 32 °F - 77 °F
Temperatura ambiente admisible durante el almacenamiento	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
Humedad (relativa, sin condensación)	20 % - 80 %

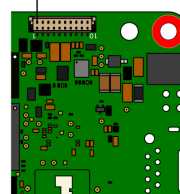
Conexiones

Conexión de interfaz	ZIF
Conexión I/O	Conector Wuerth de 10 polos (WR-WTB 1.00 mm)
Alimentación	12 V - 24 V

Asignación de pins conexión I/O

1	Tensión de alimentación (VCC) 12-24 V
2	Fuente de alimentación, masa
3	General Purpose I/O (GPIO) 2, 3,3 V - Line 3
4	General Purpose I/O (GPIO) 1, 3,3 V - Line 2
5	I2C SCL (Signal Clock) 3,3 V
6	I2C SDA (Signal Data) 3,3 V
7	Entrada de disparador sin optoacoplador 3,3 V - Line 0
8	Salida de flash sin optoacoplador 3,3 V - Line 1
9	Masa (GND)
10	Salida de tensión 3,3 V, máx. 100 mA

Pin 1



Diseño

Conexión del objetivo	No mount
Grado de protección IP	-
Dimensiones	45,0 mm x 45,0 mm x 10,0 mm
Peso	12 g
Material de la carcasa	-

Features

Lista de funciones de preprocesamiento de imágenes integradas en la cámara.

Todas las funciones de la tabla están disponibles a través de nuestro software IDS peak para el preprocesamiento de imágenes en el ordenador host (según el modelo de sensor).

GV-53D2LE-M-MB Rev.2 (1011701)

Adquisición de imágenes	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	-
	Denoiser	✓
	Long exposure	-
	Line scan	-
Flash	Flashing	✓
	PWM flashing	-
Ajustes de imagen	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
Procesamiento de imágenes integrado	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
Otros	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	-
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.62.25422